

部品内蔵基板に参入

富士プリント工業

パナソニックから技術

小ロット需要開拓

【立川】富士プリント工業（東京都八王子市、荒井眞澄社長、042・650・8181）は、部品内蔵基板の製造に乗り出す。パナソニックから部品内蔵基板「SIMPACK（シンパクト）」の技術供与を受け、本社工場に製造設備を導入した。試作・開発や月産100～1000枚の小ロットの需要を掘り起こす。2月に生産を開始し、2014年4月期に売上高1億円を目指す。

結売上高は約16億円で増収増益を見込んでいる。

富士プリント工業は40年以上あるシンパクト関連の特許すべてを使用できる。現在、専任者が技術指導を受けて製造技術を習得中。製造設備は約1億円を投じ、クリーン度を高めた部屋に部品内蔵用のプレス機、品質保証のための信頼性評価装置などを導入した。

品や半導体を多層プリント基板に内蔵できる3次元実装モジュール。部品の内蔵により通常の基板実装に比べて小型化が可能。携帯電話では基板サイズを従来の4分の1まで縮小した事例がある。また、異なる層の配線間を任意の位置で接続するインナーヒブ（穴）構造により最短の配線を実現でき、ノイズに強い。

小型・高機能化が求められる機器、ノイズ対策が必須の医療機器など新規用途を開拓する。ただ、競合する大手企業が手がけるスマートフォン（多機能携帯電話）向けなど量産用途は狙わず、小ロットと試作・開発に特化して差別化を図る。同社では、小ロットのプリント基板製造に強みを持ち、13年4月期の連